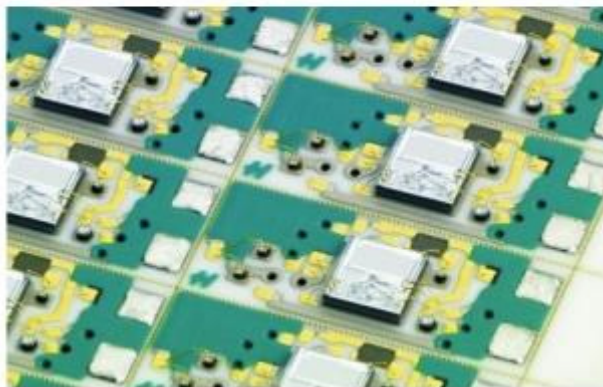


CHIPS SIZE :	0.2—10 mm DE COTE EPAISSEUR 50µm	SUBSTRATS :	THICK FILM CERAMIC FR4, FR5, G10, G11, ROGERS, FLEX RIGID , FLEX, IMS, PYREX ...
TRACABILITE :	WAFER MAPPING		
PRECISION DE POSE :	STANDARD +/- 30 µm SPECIFIC +/- 15 µm	COLLES :	CONDUCTRICE NON-CONDUCTRICE SILICONE TAMPON SERINGUE SERIGRAPHIE
EMBALLAGE :	WAFER JUSQU'À 8 '' BOITE ALVEOLEE 2-4'' GELPACK	REPORT DE COLLE :	



**4 MACHINES AUTOMATIQUE
DE POSE DE PUCES**

NOUS POSONS DES PUCES DE DIFFERENTES TAILLES ET EPAISSEURS SUR DE NOMBREUX TYPES DE SUBSTRATS.
LA PRECISION DE POSE NECESSAIRE ET LES AUTRES SPECIFICATIONS SONT DETERMINEES EN COLLABORATION AVEC LE CLIENT.

